

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2026年度“提質增效重回報”行動方案》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

公司秘書 / 董事會秘書

郭光莉

中國上海，2026年3月26日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黃登山

獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元

* 僅供識別

中芯国际集成电路制造有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，于 2025 年 3 月 27 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 28 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

2025 年，公司聚焦主业发展、深化技术创新、强化内控治理，推进“产能建设上台阶、绑定客户拓市场、降本增效优运营”，持续提升公司核心竞争力；公司亦通过优化投资者关系管理，并将 ESG 治理深度融入运营与决策全过程，向资本市场积极传递公司价值。

2026 年，公司将持续做优存量、挖掘增量，巩固稳健向好的增长态势，在经营管理、研发创新、公司治理、投资者关系及践行 ESG 理念等方面采取积极措施，推动公司高质量发展，保障投资者权益，进一步增强公司可持续发展韧性。

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦集成电路代工主业，深耕服务全球客户

——持续夯实运营基础，经营业绩再上台阶

公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者。基于国际化运营的理念，为全球客户服务，建立了辐射全球的服务基地与运营网络。

2025年，半导体产业链向本土化切换带来的重组效应贯穿全年。中国本土的设计公司抢抓发展机遇，供应链份额稳步提升。公司瞄准客户细分市场产品需求，加速验证并扩产上量，使得公司在2025年经营业绩再上新台阶，产收规模实现新跨越。公司全年实现销售收入人民币673.23亿元，同比增长16.5%，创历史新高，继续巩固全球纯晶圆代工企业第二位置；毛利率22%，同比提升3个百分点；折合8英寸标准逻辑月产能达到105.9万片，较上年末新增11.1万片；年平均产能利用率达到93.5%，同比提升8个百分点。此外，公司顺应发展需要，稳步推进中芯南方增资扩股、中芯北方少数股权收购，并协同产业链伙伴发起成立先进封装研究院。

展望2026年，产业链海外回流、国内客户新产品替代海外老产品的效应将持续显现，为国内半导体产业链带来持续的增长空间。公司将持续做优存量、挖掘增量，凭借在BCD、模拟、特殊存储、MCU、中高端显示驱动等细分领域中的技术储备与领先优势、结合客户的产品布局，巩固稳健向好的增长态势。在外部环境无重大变化的前提下，公司预计2026年销售收入增幅高于可比同业的平均值。

二、持续研发创新投入，促进提升新质生产力

——健全平台布局，加强技术储备

中芯国际拥有全方位一体化的集成电路晶圆代工核心技术体系，能快速有效地帮助客户实现新产品的导入验证到稳定量产。中芯国际

成功开发了 8 英寸和 12 英寸的多种技术平台，为客户提供“一站式”晶圆代工和技术服务。

2025 年，公司研发投入合计人民币 55.19 亿元，占销售收入比例为 8.2%。公司始终坚持自主研发的道路并巩固自主化核心知识产权，至 2025 年底，公司已累计申请专利 20,403 件，累计授权 14,511 件，申请和授权专利的数量均在中国大陆半导体制造业领先。

在产品平台建设方面，公司积极响应客户需求，持续推进工艺迭代和产品性能升级，为客户提供更高质量的解决方案。

在 28 纳米工艺领域，公司 28 纳米超低漏电平台已发布新一代 PDK 及配套标准单元库、存储编译器设计工具包，目前正导入多款不同类型产品开展验证工作；28 纳米嵌入式闪存平台已完成关键工艺开发，实现全流程贯通，SRAM 及闪存基本功能顺利达成。

在模拟器件领域，公司 8 英寸及 12 英寸模拟 BCD 平台持续迭代升级。8 英寸方面，公司完成新一代汽车电子系统 BCD 平台产品导入，发布新一代中高压 BCD 平台 PDK，并完成 SOI BCD 平台工艺及器件开发；12 英寸 90 纳米工艺方面，公司分别推出新一代低压、中压 BCD 平台 PDK，低压平台性能进一步提升，中压平台电压域范围有效拓宽，目前两个平台均已进入客户新产品设计阶段。

在高压显示驱动领域，公司新一代中尺寸显示驱动平台已实现规模量产，新一代大尺寸显示驱动平台完成工艺开发，PDK 正在开发中。

同时，公司 65 纳米射频绝缘体上硅平台、0.18 微米嵌入式存储车用平台等多个项目均取得阶段性进展与成果。

2026 年，公司将持续投入研发，在丰富平台的基础上提升研发能力，加快推动技术的工程化、产品化、市场化；坚持以市场需求为导向，以服务客户为中心，进一步健全车规级工艺平台布局，加强存储类产品技术储备，抢抓行业景气周期机遇；以高效专业的创新能力护航公司科技发展，持续构筑核心竞争优势。

三、聚焦公司治理体系建设，以高效能治理引领高质量发展

——强化内控治理建设，助力“关键少数”合规履职

公司是一家设立于开曼群岛并在香港联交所及上交所科创板两地上市的红筹企业，现行的公司治理制度主要系基于公司注册地和境外上市的相关法律法规及规则制定。公司一直高度重视公司治理水平的提升和完善，不断强化在内控制度、规范运作等方面的合规管理。

2025 年，在内控治理建设方面，公司开展年度内部控制评价，通过梳理公司各项规章制度，优化内部控制环境，提高内部控制管理水平。同时，公司贯彻落实相关法律法规要求，制定了《市值管理制度》，修订了《审计委员会章程》《提名委员会章程》《企业管治政策》《内部审计管理制度》《关联（连）交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度及细则，并进一步优化公司治理、信息披露相关制度及工作流程。

在“关键少数”履职方面，公司向董事发送上市公司证券监管资讯 5 次，内容有关两地资本市场新规解读和监管指引，并安排董高参加联交所企业管治新规、商业行为与道德合规、ESG 等主题培训。此

外，公司专门向大股东提示两地股份变动规则及相关监管动态，协助其明确所持有公司 A 股及港股股份变动的不同披露及申报要求，减少违规风险。公司通过加强大股东、董高等“关键少数”的合规意识，提升其履职能力，实现公司合规稳健发展。

2026 年，公司将聚焦公司治理体系建设，持续完善董事会建设，围绕风险管理、人才梯队、战略管理等重点开展三大专项建设，加强制度顶层设计并切实提升公司治理水平。此外，公司将继续紧密关注资本市场新规和监管动态，落实有关法律法规要求，修订优化公司内部治理制度，组织董高线上、线下培训及阅读相关资料不少于 60 人次，强化“关键少数”责任，推动公司持续规范化运作。

四、加强投资者双向沟通，构建多种沟通渠道

——*优化投资者关系管理，强化长期价值投资认同*

公司始终高度重视投资者关系管理，持续构建多渠道、多层次的投资者双向沟通体系。2025 年，公司召开四次业绩说明会，管理层与资本市场就经营管理、财务状况、产品技术、产能建设等事项进行充分沟通，主动回应投资者关切。年度股东大会方面，公司优化基础设施建设，提升股东参会体验；在公告中发布预登记二维码，预收集股东关切的问题，提高会议效率；在股东大会后，公司管理层、董事会秘书、投资者关系团队细致回应股东提出的各类问题。公司亦通过官网、投资者咨询电话及邮箱、上证 e 互动、路演、反路演、调研等多元化渠道与平台和投资者保持常态化互动，广泛收集意见建议并形成专项报告呈报管理层。

此外，2025 年公司严格执行《市值管理制度》，对相关指标实施监测与动态跟踪管理，持续提升投资者关系管理规范化水平；积极引导主要股东关注资本市场动态与投资者诉求，切实维护资本市场稳定运行。

2026 年，公司将持续优化投资者关系管理工作，继续执行《市值管理制度》，监测相关指标变动情况并落实跟进措施；计划召开不少于三次业绩说明会，保持公司管理层与全球投资者的常态化沟通交流。此外，公司将继续通过上述多元化渠道与平台，深化投资者互动，保障投资者高效、准确获取公司经营发展动态。围绕“价值传递、长期共赢”的核心目标，助力投资者更全面理解公司长期发展战略与内在价值，构建稳定、良好、互信的长期投资者关系。

五、深化 ESG 治理实践，推动绿色与社会责任协同发展

——聚焦低碳生产，深化责任赋能

公司始终贯彻 ESG 新发展理念，坚定不移走履责合规、安全环保和开放共赢的高质量发展道路，将 ESG 治理深度融入生产运营全过程，以治理之“稳”保障发展之“进”。

2025 年，公司 ESG 工作成果丰硕：完善 ESG 治理，优化决策机制，明确 ESG 管理职责，强化内控风控，推动合规向供应链延伸；践行绿色低碳，以“双碳”目标为引领推进节能减排与环境治理，着力构建集约高效、清洁低碳的生产运营体系，通过工厂用地布局优化、原料无害化处理、产线洁净化改造、废弃物资源化利用，持续推动能源结构绿色转型，公司已有 6 个厂区获评国家级绿色工厂认证，累计购买绿电超 142,123.9 兆瓦时，并顺利完成年度碳市场履约，与此同

时，公司始终将安全生产摆在首要位置，扎实推进“治本攻坚提升”行动，建设总部应急中心，推动安全管理智能升级，以高水平安全护航高质量发展；坚持以人为本，优化人才激励与发展体系，深化人文关怀，年度员工公益奉献超 2 万小时，“芯肝宝贝计划”累计捐款近 5,523 万元，帮助 1,226 名患儿康复。公司自 2013 年起连续荣获《镜报》“杰出企业社会责任奖”，入选 2025 年央视“中国 ESG 上市公司科技创新先锋 30”榜单等荣誉。

2026 年，公司将坚守晶圆代工主业，继续深化 ESG 治理效能，持续加大在绿色技术研发与应用上的投入，推动生产工艺的低碳化转型，携手合作伙伴提升产业链韧性，实干担当、开放共赢，加快建设世界一流集成电路制造领军企业，打造社会需要，受人尊重的负责任企业。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日